

杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议和 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》，同意公司与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）以货币方式共同出资 160,000.00 万元认缴关联参股公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）本次新增的全部注册资本 148,155.0072 万元，其中：本公司出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；厦门半导体出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均计入士兰集科的资本公积。本次增资完成后，士兰集科的注册资本将由 382,795.3681 万元变更为 530,950.3753 万元。

本公司与厦门半导体于 2024 年 9 月 30 日在厦门市签署了《增资协议》。

上述事项详见公司于 2024 年 9 月 12 日、9 月 28 日和 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2024-062、临 2024-066 和临 2024-068。

二、对外投资进展情况

士兰集科已于 2024 年 12 月 12 日办理完成了相应的工商变更登记。截至本公告披露日，士兰集科最新的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门半导体投资集团有限公司	329,119.1536	61.987	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	145,731.9891	27.447	货币
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	56,099.2326	10.566	货币
合计	530,950.3753	100.00	-

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年12月13日